

## 日月光九十年度第二季業績簡訊

日月光於台灣時間 90 年 8 月 3 日同步於美國及台灣兩地發佈第二季獲利報告，因半導體產業景氣持續下滑，致本公司第二季單季之營業收入較去年同期衰退 31.7%，為新台幣 8,499 百萬元，另營業毛利、營業利益及稅後純益亦呈現衰退局面。茲將日月光第二季單季之營運成果及其產品結構比重表列如下：

表(一)日月光第二季單季簡明營運成果分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	90 年度第二季	89 年度第二季	90 年上半年
營業收入	8,499	12,436	19,749
營業毛利	910	3,831	3,293
營業利益	(579)	2,478	389
稅前純益	(917)	2,078	(235)
稅後純益	(618)	1,457	(267)
稅後 EPS(元)	(0.22)	0.55	(0.10)

表(二)整體業務之產品結構

產 品 項 目	占營收比率(%)
通訊產品	38
汽車及消費性電子產品	35
個人電腦	26
其他	1

表(三)銷售地區分析

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	66
歐洲	4
個人台灣	26
日本	2
亞洲其他	2

表(四)封裝業務之產品結構比重分析表

產 品 項 目	占營收比率(%)
通訊產品	37
汽車及消費性電子產品	36
個人電腦	26
其他	1
第二季打線機台數	3,991

表(五)測試業務之產品結構比重分析表

產 品 項 目	占營收比率(%)
通訊產品	39
汽車及消費性電子產品	32
個人電腦	28
其他	1
第二季測試機台數	1,052

日月光董事長張虔生表示，全球半導體產業在第二季持續疲軟，在個人電腦、通訊及消費性電子三方面都面臨需求下滑的挑戰。就日月光之營運而言，封裝與測試業務亦較今年第一季衰退，而且整體產業之能見度仍然甚低。但另一方面，我們亦發現客戶提供之預估已漸趨穩定，而且實際之下單量與預估需求之差異也漸漸縮小，由此我們相信今年下半年產業之景氣應自第四季起逐漸回昇。

同時，過去一季日月光在最尖端的封裝技術上已獲得重大的成就，例如我們位於高雄的晶圓凸塊業務便持續快速的成長，而我們經由此一業務的拓展，也成功的開發了數個主要的整合性元件大廠(IDM)的客戶，此外我們為威盛電子與全美達(Transmeta)的新世代之微處理器所提供的最先進之封裝與測試服務，更是日月光技術能力的最佳實證。日月光將持續開發最先進的封裝與測試技術，以進一步鞏固我們的領先地位。